

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2022-004

## 湖北鼎龙控股股份有限公司

### 关于公司抛光液产品通过客户端验证并开启计划采购的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）近年一直围绕集成电路核心 CMP 全局平坦化工艺材料作为发展重点和延展方向，依靠公司在化学材料领域和工程化领域二十年的技术积累，公司控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司的氧化铝抛光液产品在某家公司 28nm 节点 HKMG 工艺的 Al CMP 制程验证通过。该产品使用氧化铝研磨粒子和高分子聚合物，是所有抛光液中技术最难的关键材料，公司已突破技术难关，实现三种关键材料的自主制备。该款搭载公司自制研磨粒子的抛光液产品，是目前尚未取得国产化材料突破的卡脖子抛光液型号之一，难度极高，其各项参数均达到客户应用要求，通过客户端全方面工艺参数验证，并已进入吨级采购阶段。

抛光液是集成电路制造中晶圆平坦化工艺的重要材料，其组分包含研磨粒子与化学成分，因而对其性质的控制，是决定化学机械平坦化制程中化学能力与机械作用的关键。从硅晶圆制造，到集成电路器件构建，再到芯片封装环节，抛光液被认为是贯穿于芯片“从砂到芯”的全流程材料。其中，研磨粒子是抛光液的核心，是世界公认的“技术护城河”。目前公司研磨粒子已实现“卡脖子”关键核心技术重大突破，可以满足客户定制化需求。

目前，公司各制程抛光液在中国各个主流厂商的验证评价和市场推广工作已全面展开，部分客户的初步评价已经获得了客户端极好的评价结果。产能建设方面，武汉本部工厂一期全自动化抛光液生产车间已经建成，具备年产 5000 吨抛光液的生产能力，能够满足客户端订单需求。公司将根据市场情况尽快研究部署二期产能建设。

本项目是公司 CMP 全局平坦化综合解决方案的重要组成部分，也将形成公司新的新产品增长级。公司将视相关产品及项目的进展情况持续履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日